

2010年3月期決算説明会資料

～09年度事業構造改革を完遂、10年度はV字型回復へ～

2010/4/26

 株式会社日立ハイテクノロジーズ

執行役社長 大林 秀仁

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

2010年3月期 決算説明会

I 2010年3月期 決算概要

II 2011年3月期 経営方針

III 2011年3月期 業績予想

IV 参考:データ集

I 2010年3月期 決算概要

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

2010年3月期決算(ハイライト)

(億円)

	当期実績	前年同期比		前回予想比	
		増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	6,169	△1,581	△20%	+169	+3%
営業利益	△16	△165	—	+37	—
経常利益	△5	△170	—	+40	—
当期利益	△28	△99	—	+25	—
一株利益	△20円55銭	△71円99銭		+17円98銭	
一株配当	15円00銭	△15円00銭		+5円00銭	
ROE	△1.2%		△4.2%		—
FIV	△122		△101		—
FCF	+141		+17		—

* 前回予想(2010年1月公表値)

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

4

■ FIV(日立式経済付加価値)

FIV(Future Inspiration Value) = 税引後事業利益 - 投下資本コスト

対前回予想値偏差説明

1. 売上高・営業利益(2010年1月3Q決算発表時比較)

売上高 (6,000億円 → 6,169億円 +169億円)

- 電子デバイスシステム:半導体製造装置への投資回復等により21億円増加
- ライフサイエンス:医用分析装置の好調等により20億円増加
- 情報エレクトロニクス:米国市場向け携帯電話取引の売上増等により50億円増加
- 先端産業部材:素材価格の上昇及び自動車部品の需要回復等により78億円増加

営業利益 (△53億円 → △16億円 +37億円)

- 電子デバイスシステム:半導体製造装置の売上増及び操業度改善等により22億円増加
- ライフサイエンス:医用分析装置の好調等により8億円増加
- 情報エレクトロニクス:米国市場向け携帯電話取引の売上増等により5億円増加

2. 事業構造改革(2009年10月2Q決算発表時比較)

	前回予想	実績	偏差
固定費削減	△85億円	△85億円	±0億円
人員の適正化	△1,450人	△1,500人	△50人

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

5

■売上高・営業利益

09年度実績の前回予想比偏差説明は上記の通り。

世界的な景気底打ちに加え、半導体製造装置への投資回復が貢献し、上方修正となった。

■事業構造改革

固定費削減(08年度比)

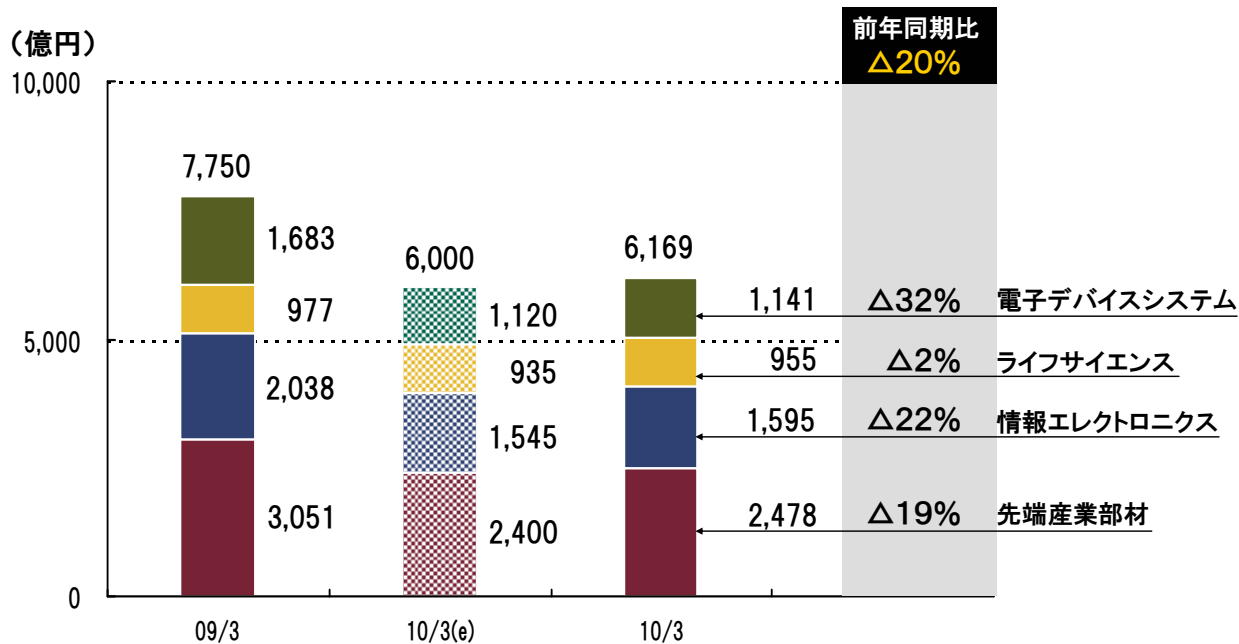
- ・前回予想に対し、計画通りに進捗

人員の適正化(09/3末比)

- ・前回予想に対し、50人縮減

2010年3月期決算(セグメント別売上高)

売上高



(e)は前回予想(2010年1月公表値)

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

6

■前年同期比増減説明

・電子デバイスシステム

半導体製造装置(商事品)の一部取扱中止に加え、液晶関連製造装置を中心とした投資抑制の影響等により前年同期比 △32%

・ライフサイエンス

バイオ・分析は、DNAシーケンサ等が堅調に推移したものの、メディカルは生化学・免疫装置の製品納入一巡等により減少し、全体では前年同期比 △2%

・情報エレクトロニクス

世界的な景気悪化によるチップマウンタ等の設備投資抑制や、情報システム、半導体デバイス等の需要減により前年同期比 △22%

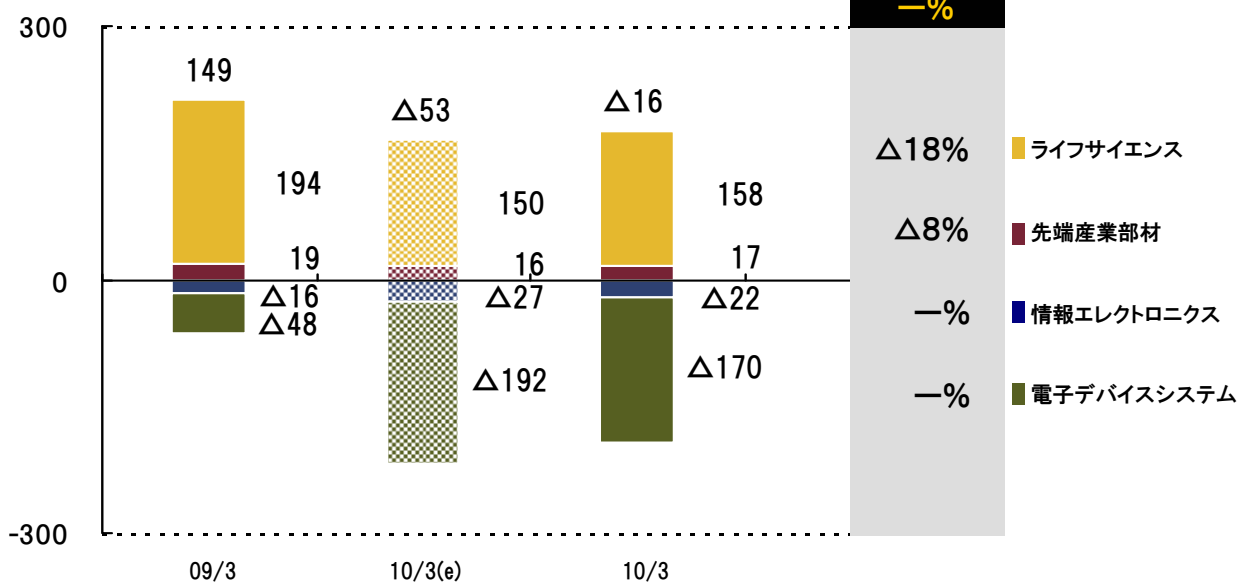
・先端産業部材

世界的な景気悪化に伴い、太陽電池関連部材等一部の商材を除き、工業材料、電子材料全般に販売が悪化、前年同期比 △19%

2010年3月期決算(セグメント別営業利益)

営業利益

(億円)



(e)は前回予想(2010年1月公表値)

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

■前年同期比増減説明

各セグメント共、売上高とほぼ同様の理由により営業損益が悪化

2010年3月期決算(損益計算書〔要約〕)

2010年3月期

(億円)

	当期実績	前年同期比	
		増減額	増減率
売上高	6,169	△1,581	△20%
売上原価	5,377	△1,330	△20%
売上総利益	792	△250	△24%
販売費及び一般管理費	808	△85	△10%
営業損失	△16	△165	—
営業外収益	19	△6	△25%
営業外費用	8	△2	△20%
経常損失	△5	△170	—
特別利益	6	△3	△35%
特別損失	22	△13	△37%
税金等調整前当期純損失	△21	△160	—
法人税等	7	△61	△90
当期純損失	△28	△99	—

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

8

■ポイント説明

- ・販売費および一般管理費 △85億円
(人件費 △26億円、その他 △59億円)
- ・営業外収益 △6億円
(受取配当金 △5億円、その他 △2億円)
- ・特別損失 △13億円
(投資有価証券売却・評価損 △5億円、減損損失 △5億円、事業構造改革費用 △5億円、その他 +2億円)

2010年3月期決算(貸借対照表〔要約〕)

2010年3月末（億円）

		09/3末比				09/3末比	
流動資産		3,248	△158	流動負債		1,557	△112
現預金、関係会社預け金	1,017	+118		支払手形及び買掛金	1,100	△38	
受取手形及び売掛金	1,445	△98		その他	457	△74	
たな卸資産	572	△148		固定負債		259	△4
その他	213	△30		退職給付引当金	253	△1	
固定資産		863	△7	その他	6	△3	
有形固定資産	559	△25		純資産		2,294	△49
無形固定資産	49	+7		株主資本	2,293	△56	
投資その他の資産	254	+12		評価・換算差額等	△1	+7	
				少数株主持分	3	+0	
資産合計		4,110	△165	負債及び純資産合計		4,110	△165

■ポイント説明

・流動資産

たな卸資産： 09/3末比 △148億円
 (仕掛品 △135億円、その他 △13億円)

・自己資本比率： 55.7% (09/3末比 +1.0%)

・一株当たり純資産： 1,666円00銭 (09/3末比 △35円74銭)

2010年3月期決算(キャッシュ・フロー計算書〔要約〕)

(億円)		10/3			10/3
営業活動による キャッシュ・フロー		+224	財務活動による キャッシュ・フロー		△28
税引前利益		△21	配当金の支払		△28
減価償却費		+96	その他		△0
運転資金		+175	換算差額		△8
法人税等支払・還付額		+22			
その他		△48			
投資活動による キャッシュ・フロー		△83			
有価証券の取得・売却		+8			
固定資産取得・売却		△71			
その他		△20			
フリー・キャッシュ・フロー		+141			
			現金及び現金同等物		10/3
			期首残高		796
			増減額		+106
			期末残高		902

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

10

■ポイント説明

・投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・売却 △71億円

(那珂事業所製造棟関連支出 △37億円、その他 △34億円)

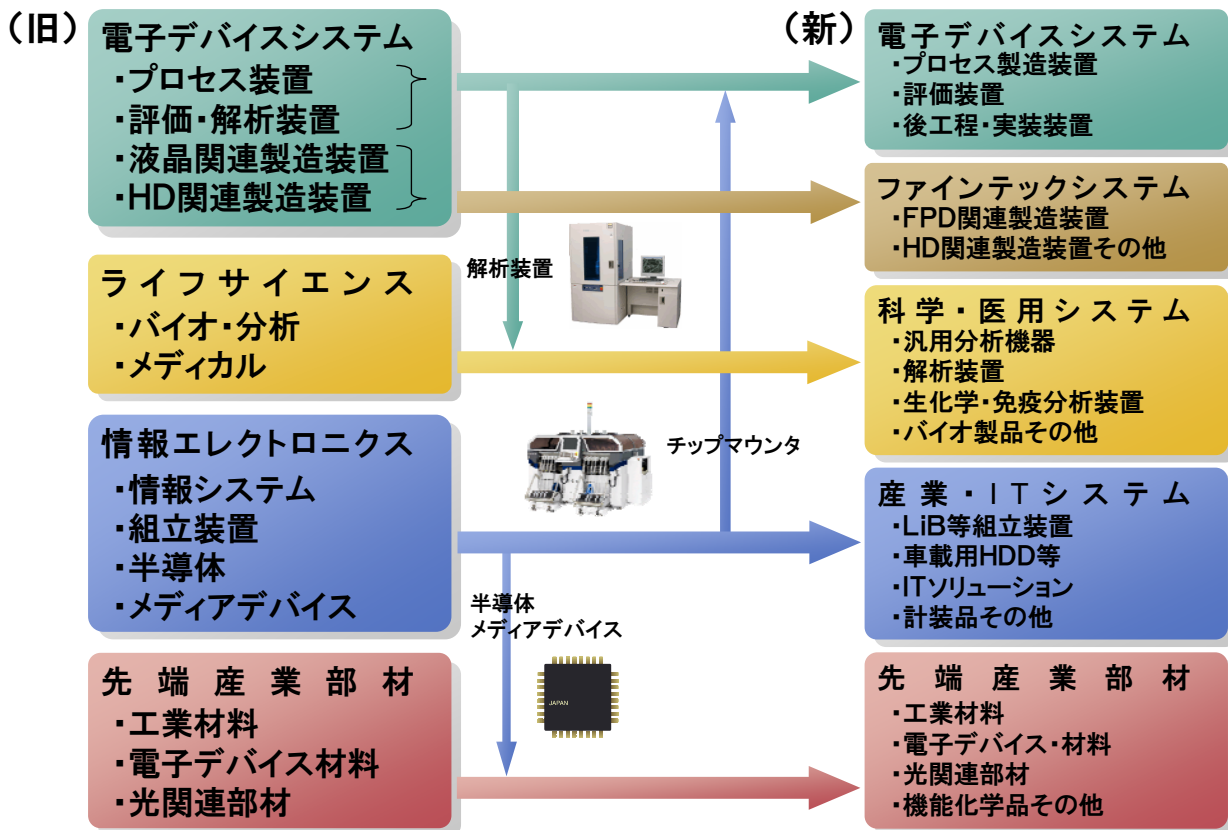
・10/3末現金および現金同等物(902億円)とB/S現預金・関係会社預け金(1,017億円)との差額 △115億円

(預入れ3ヶ月超の定期預金・関係会社預け金 △170億円、その他 +55億円)

Ⅱ 2011年3月期 経営方針

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

セグメント区分の変更



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

12

■セグメント区分の変更

10年度より、会計基準が変更され、従来のセグメント区分を「マネジメントアプローチ」に基づくセグメントに変更する。

概略は図の通り。

新セグメントの主な変更内訳(カッコは旧セグメント)

- ・電子デバイスシステム
プロセス・評価・後工程装置にチップマウンタ(情報エレクトロニクス)を移管
- ・ファインテックシステム
液晶・HD関連製造装置(電子デバイスシステム)を独立
- ・科学・医用システム
バイオ・分析、メディカル(ライフサイエンス)に解析装置(電子デバイスシステム)を移管
- ・産業・ITシステム
チップマウンタを電子デバイスシステムへ移管
半導体・メディアデバイスを先端産業部材へ移管
- ・先端産業部材
半導体・メディアデバイス(情報エレクトロニクス)を移管

*09年度実績(新旧セグメント)リステート明細は巻末参照

V字型回復の実現と 成長戦略の加速

1. 経営改革の着実なる実行

- 新事業創生活動の展開
- 真のグローバル企業への変貌
- 商事機能の強化
- キャッシュフロー経営の強化

2. 経営環境の変化に対応した事業戦略の遂行

High-Technology.
先端技術の中に、高度なエコを。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

13

■2011年3月期 経営方針

1. 経営改革の着実なる実行

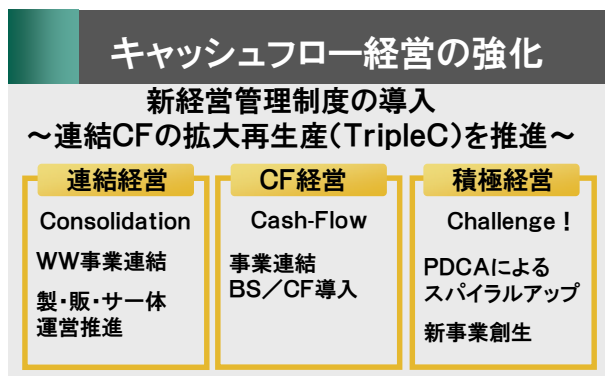
厳しい経営環境下、緊急軽量化対策のみならず明日への布石として経営改革にも積極的な取組みを実施

2. 経営環境の変化に対応した事業戦略の遂行

リーマンショック前後の環境変化を大きなパラダイムシフトと捉え、戦略の見直し・アップデートを実施



- ### 商事機能の強化
- 商事部門を統括する 商事戦略部門の新設 (戦略機能)
 - 環境・エネルギー部門の新設 (伸長分野への注力)
 - 高付加価値ビジネスへの移行促進 (選択と集中)



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

14

■経営改革の着実なる実行

1. 新事業創生活動の展開

- ①09年度より実施
- ②目的＝既存事業の枠を超え、将来の当社の収益の柱となりうる事業の創生(当社の将来のコア事業創生)
- ③10年度より社内に専任組織(新事業創生部・Cプロ推進センタ)を創設

2. 真のグローバル企業への変貌

グローバル・グランドデザインを策定し、図に示す四つの重点課題を中心に全社的取組みを加速

3. 商事機能の強化

商事部門のポートフォリオの組替えを加速するとともに、日立グループの社会イノベーション事業への貢献を推進

4. キャッシュフロー経営の強化

キャッシュフロー重視の観点から、PDCAサイクルの全てを、ITも有効に活用し、抜本的に見直し

セグメント	経営環境	事業戦略
電子デバイスシステム	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体装置市場は過去ピーク未達と予想 ・微細化技術の開発継続 ・前工程から後工程への付加価値シフト（前工程微細化の物理的限界への近接） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ポストセールス強化と非半導体分野への進出 ・微細化に向けた新製品の継続投入 ・後工程・実装システムを収益源に育成
ファインテックシステム	<ul style="list-style-type: none"> ・液晶関連市場は中国向け投資増加により価格競争激化 ・HD関連市場は高密度化・増産により投資の動きあり 	<ul style="list-style-type: none"> ・抜本的原価低減の推進 ・新製品・新規事業へのリソースシフト
科学・医用システム	<ul style="list-style-type: none"> ・電顕市場は緩やかに伸長、新材料分析ニーズ高まる ・体外診断市場・DNAシーケンサ市場は一桁成長 ・免疫は成長、生化学は飽和 	<ul style="list-style-type: none"> ・電顕・分析システム事業のシナジー創出 ・SCB*継続・深化による収益拡大 *System Collaboration Business ・遺伝子等伸長市場での事業拡大
産業・ITシステム 先端産業部材	<ul style="list-style-type: none"> ・エコ自動車（EV、HEV等）、環境・エネルギー（太陽光、風力等）市場の急成長 ・新興国市場の台頭 	<ul style="list-style-type: none"> ・エコ自動車・環境・新エネルギー関連市場への注力 ・自社製品部門との協働による高付加価値事業の拡大 ・新興国市場でのビジネス拡大

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

■経営環境の変化と事業戦略

セグメント毎の戦略の骨子を示す。

具体的な施策・実施例等については後述。

Ⅲ 2011年3月期 業績予想

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

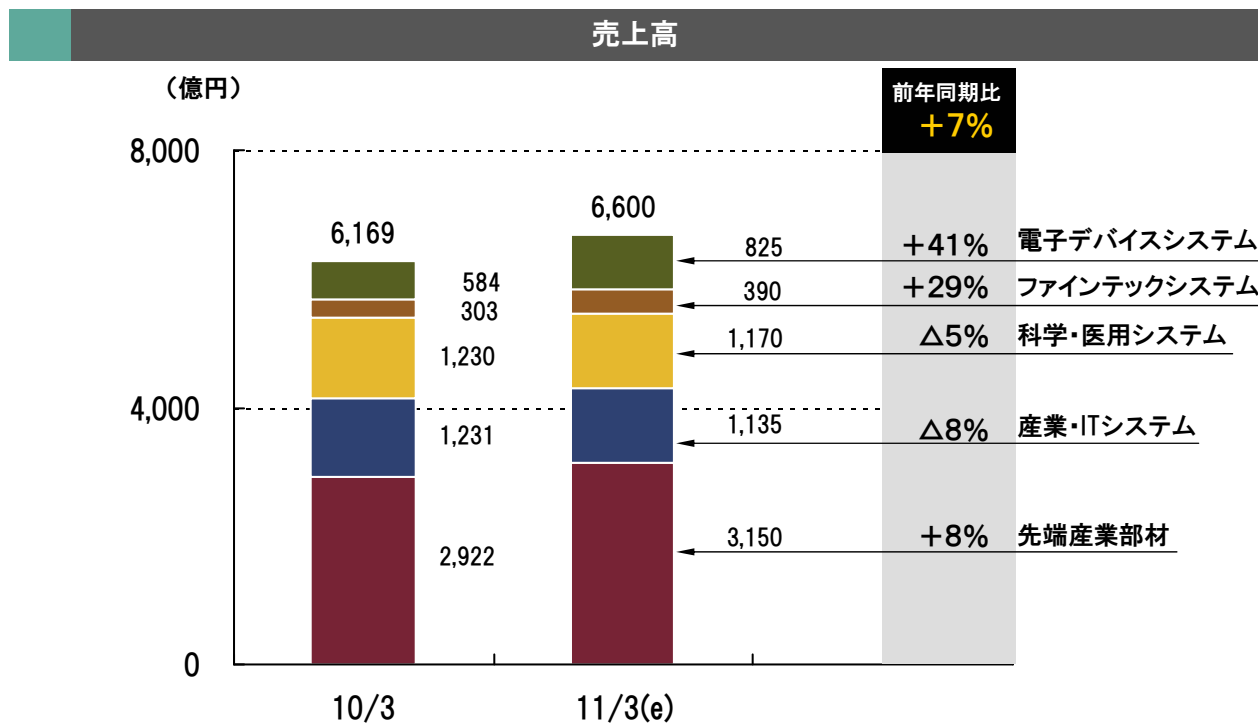
2011年3月期業績予想(ハイライト)

(億円)

	当年度予想	前年度実績	前年同期比	
			増減額	増減率
売上高	6,600	6,169	+431	+7%
営業利益	172	△16	+188	—
経常利益	175	△5	+180	—
当期利益	106	△28	+134	—
一株利益	77円07銭	△20円55銭	+97円62銭	
一株配当	20円00銭	15円00銭	+5円00銭	
ROE	4.6%	△1.2%	+5.8%	
FIV	△12	△122	+111	
FCF	+115	+141	△26	

(注)想定レート: 1USD= 85円
1EUR=125円

2011年3月期業績予想(セグメント別売上高)



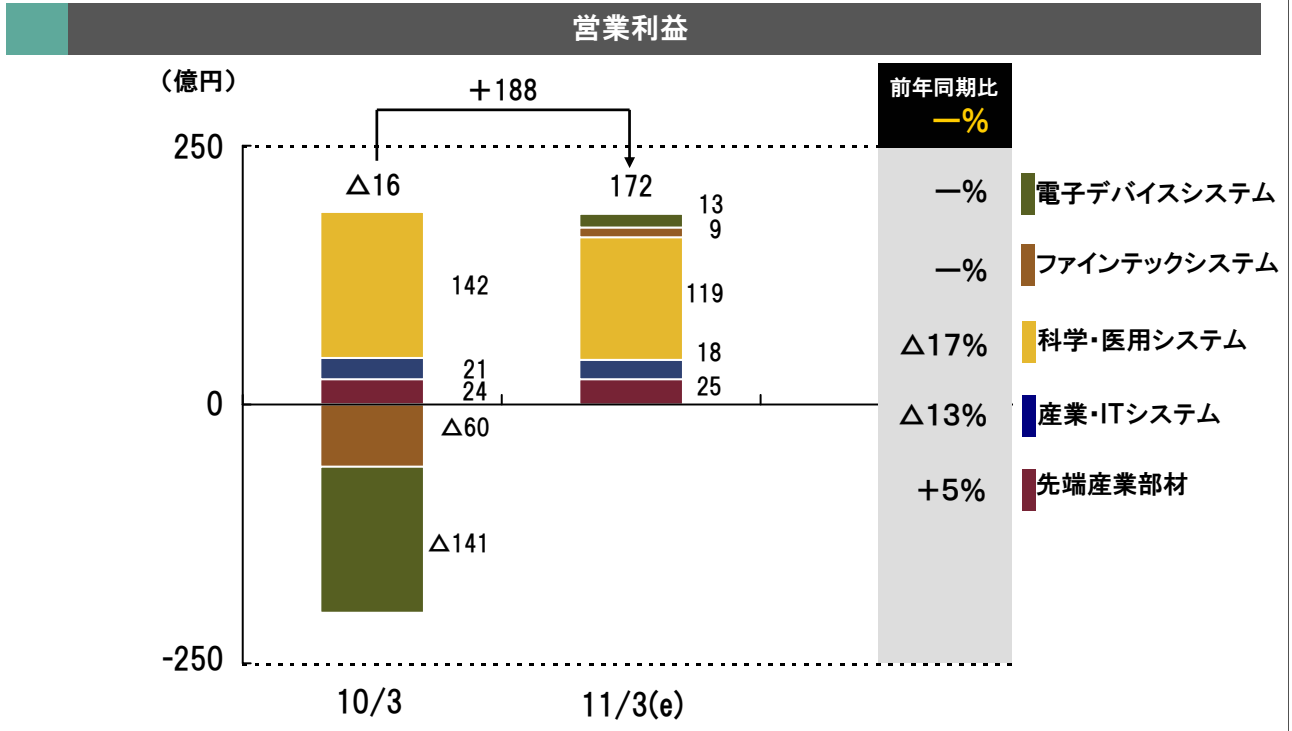
(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

■前年同期比増減説明

- 電子デバイスシステム**
 メモリーメーカーの量産投資再開等により、前年同期比+41%を予想
- ファインテックシステム**
 日本向け液晶関連製造装置(商物品含む)は減少するも、中国向け同装置、HD関連製造装置等への投資が活発化し、前年同期比+29%を予想
- 科学・医用システム**
 解析・汎用分析装置等は、半導体や新エネルギー関連分野での投資回復が見込まれるものの、09年度補正予算案件の反動等により、前年同期比△5%を予想
- 産業・ITシステム**
 環境適合車関連の組立装置・製品等は回復するも、米国向け携帯電話取引は、現行モデルの需要減等により、前年同期比△8%を予想
- 先端産業部材**
 素材価格上昇や、自動車関連部材の需要回復等により、前年同期比+8%を予想

2011年3月期業績予想(セグメント別営業利益)

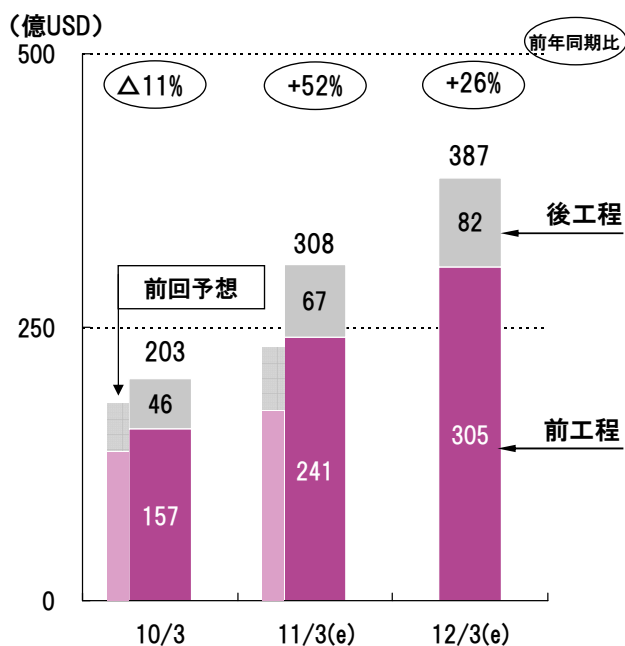


(注)合計にはセグメント間の内部取引の消去等が含まれております。

■前年同期比増減説明

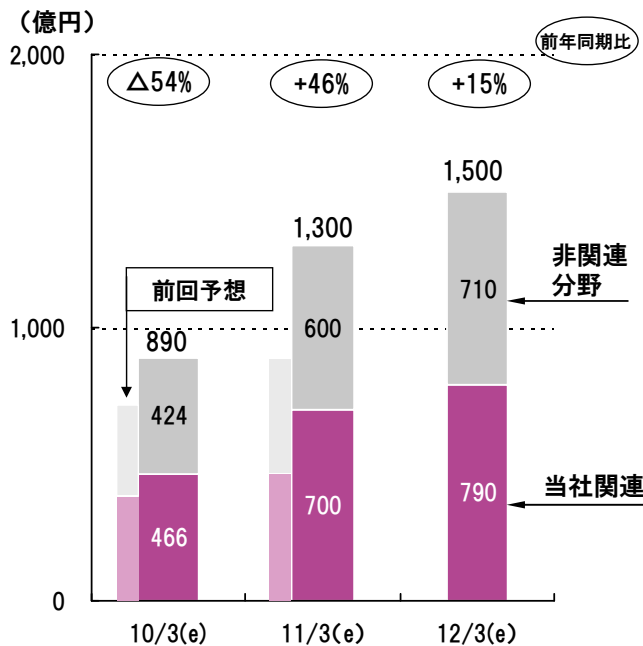
各セグメント共、売上高とほぼ同様の理由により営業損益が改善すると予想

半導体製造装置市場



(出所)Gartner(10年3月)および当社推測
 前回予想はGartner(09年9月) および当社推測

実装装置市場



(出所)日本ロボット工業会資料(09年12月)調査機関資料に基づき当社作成
 前回予想は09年10月の10年3月期2Q決算発表時の見通し

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

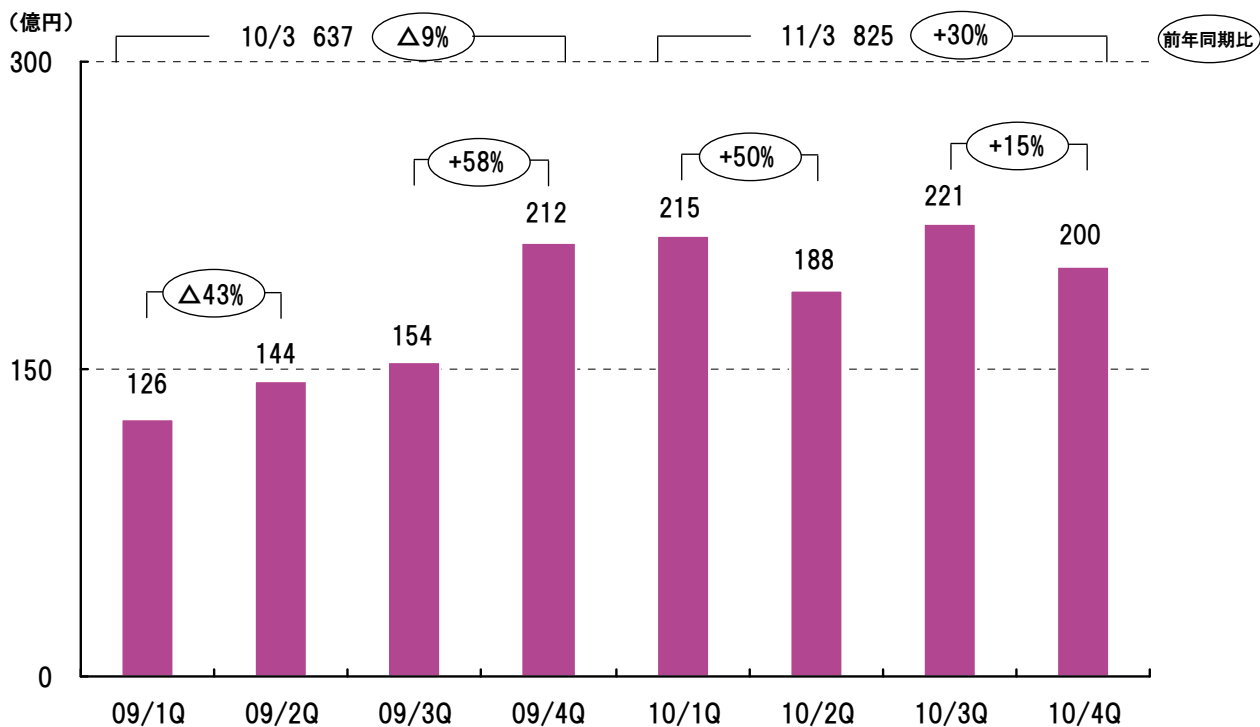
■半導体製造装置市場の状況説明

- 09年度:前半は世界的な景気後退の影響により、半導体・装置市場とも大きく縮小。
 後半にはノートPCやスマートフォンを中心としたアプリケーション市場の回復に伴い、半導体・装置市場とも回復したものの、通年では△11%のマイナス成長
- 10年度:引き続きアプリケーション需要は好調。メモリーを中心とした半導体市場は高成長が見込まれ、年後半には投資を控えていた半導体メーカーの積極的な投資の再開が期待できるため、+52%の大幅なプラス成長を予想

■実装装置市場の状況説明

- 09年度:世界的な景気後退に伴う設備投資低迷が底を打ち、09年末から特にアジア向け需要が拡大したものの、通年では△54%の大幅なマイナス成長
- 10年度:年後半の動向は不透明であるものの、アジア向けを中心に実装装置需要の回復がさらに強まると予想され、+46%の大幅なプラス成長を予想

受注高の推移



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 21

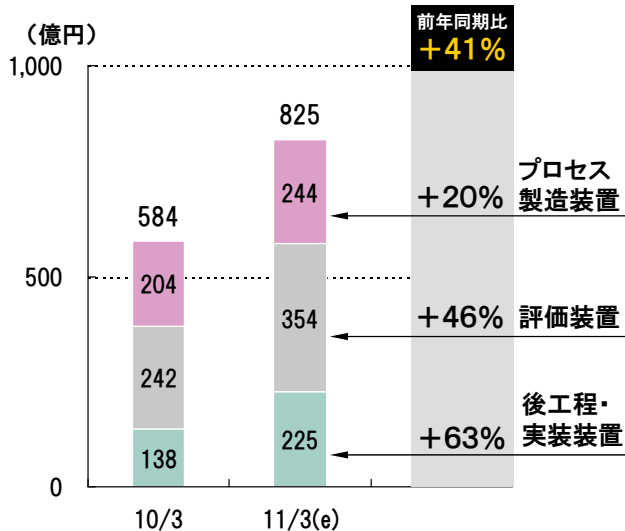
■受注高の推移

- ・10/上:海外大手半導体メーカーおよびアジア地区の後工程・実装を中心とした増産対応の設備投資再開を受け、受注は09年度後半からの高水準を維持。
 2Qには受注は一服するも、国内や他の半導体メーカーに投資の裾野が広がることにより、前年同期比+50%、前期比+10%を予想
- ・10/下:メモリーおよびMPUメーカーの投資牽引により受注は高水準を維持し、前年同期比+15%、前期比+4%を予想

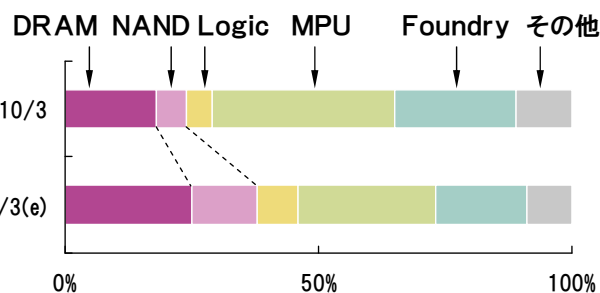
10年度基本戦略

1. 伸長分野への重点取組み
2. 微細化対応と独自優位分野の技術強化で設備投資の取込み

主要製品群別売上高の推移



前工程装置 分野別売上高比率



09年度:市場全体が縮小するなか、MPUメーカーからの売上確保
 10年度:メモリーメーカーの投資再開によりDRAM、NANDの割合上昇、08年度並に

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

22

基本戦略に対する今後の取組み

1. 伸長分野への取組み
 - ・スマートフォン、ネットブック含むノートPC、薄型TVの伸長に伴い、NAND、ASSP、DRAM、MPU向けに拡販を推進
 - ・後工程、新興国への拡大に対応した営業体制構築で売上伸長
2. 微細化対応と独自優位分野の技術強化
 - ・計算機リソグラフィー対応、ダブルパターニング、先端ゲート加工エッチング、不揮発性材料デバイス、システムティック欠陥検査などに注力

10年度 前年同期比増減説明

プロセス製造装置

- ・大手ロジック、ファブリー、メモリー顧客が設備投資を再開し、前年同期比+20%を予想

評価装置

- ・アジア市場、日本市場ともに下期まで好調が続くと見られるも、景気刺激策の持続性などのリスク要因を勘案し、前年同期比+46%を予想
- 測長SEM: 前年度後半からの微細化と量産規模拡大に向けた投資が継続され増加
- 検査装置: デバイスメーカーに加え材料、装置メーカーの投資再開にも期待

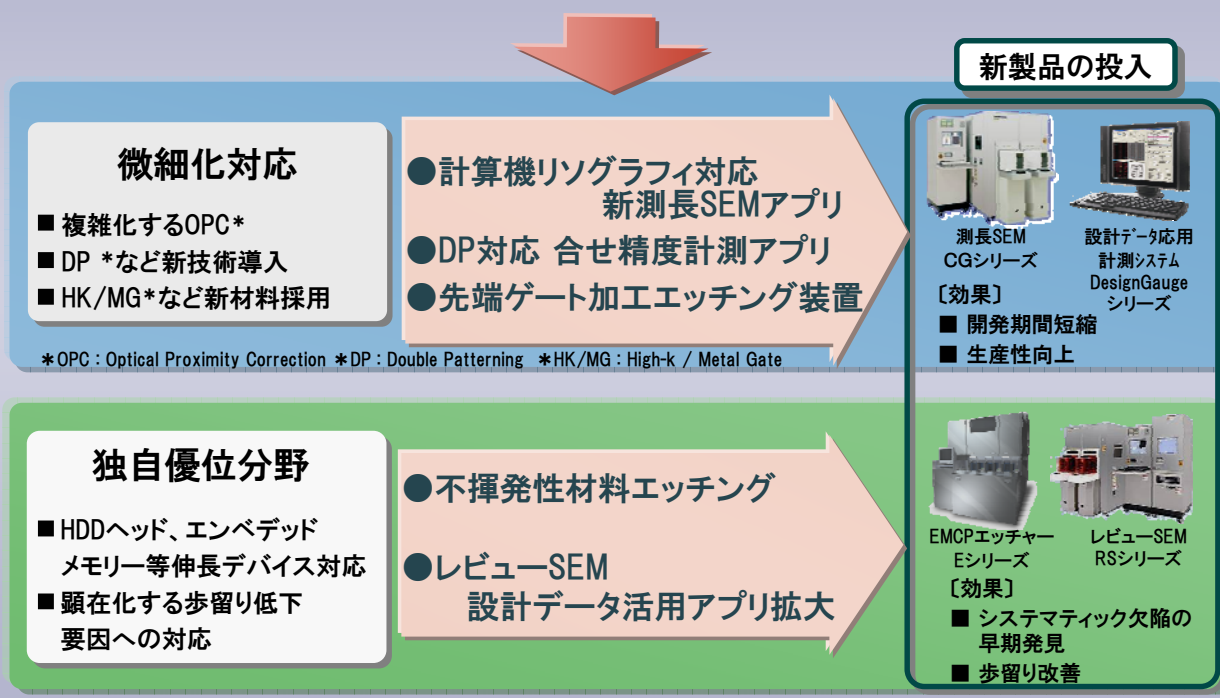
後工程・実装装置

- ・中国を中心に引き続き投資は堅調。チップ数・チップ積層数増加に伴う増産投資により、前年同期比+63%を予想

10年度 前工程装置 分野別売上高比率

- ・09年度はファブリーへの売上貢献が大きく、10年度も継続して同規模以上の売上が見込まれるが、メモリーメーカーの投資が再開され、相対的には10年度に占めるDRAM・NANDの割合が上昇

●半導体メーカー設備投資 再開(DRAM、NAND、MPU、ASSP)



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

23

■市場動向

伸長するDRAM、NAND、MPU、ASSPのメーカーに重点

■市場・顧客の要求

微細化対応

- ・微細化に伴いリソグラフィプロセスの難易度が上昇、OPC、DP(ダブルパターニング)などの複雑かつ新しい技術を導入
- ・デバイスの高性能化のために新しい材料(HK・MG)を採用。加工の難易度が上昇

独自優位分野

- ・HDDヘッド、エンベデッドメモリーなど今後伸長が期待されるデバイスへの取組みを強化
- ・製造プロセスの尤度が厳しくなり、設計起因のシステムティック欠陥が急増、歩留り低下の主要因となっており従来では検査が困難。このような新しい課題への取組み強化

■対応策

- ・計算機リソグラフィに対応した新たな測長SEMアプリケーションを提供。EDAベンダーとの協業推進
- ・DP対応の合わせ精度計測アプリケーションを新たに提供
- ・新材料対応の最先端ゲート加工対応・不揮発性材料対応のエッチャーを提供
- ・DesignGaugeで培った設計情報活用によるアプリケーションを他の検査装置にも応用拡大し、欠陥の早期発見、課題解決に寄与

半導体メーカーの開発期間の短縮、生産性の向上、歩留り改善に貢献し、設備投資を取込み

● メモリー後工程市場の伸長

NANDアプリケーションの拡大

大容量化対応

- 高集積3次元実装

ハイエンド向けDRAM

高速伝送対応

- 新型パッケージ

- 薄膜ハンドリング制御機構採用
- 多段積層対応高精度合わせ機能
- フリップチップ対応
高速ボンディング機能



(NAND/SIP対応) DB-800シリーズ (DRAM対応) CM-700シリーズ

【効果】

- 生産コストダウン
- 品質・信頼性向上

● 表面実装市場の拡大

部品の多様化

- 多品種 ■小型・薄型化

高速・高密度実装

- 高生産性 ■高信頼性

新興地域への拡大

- 高品質 ■操作性

- 多品種対応高速ヘッド・簡易段取換え機能採用
- 最先端メカ&制御技術応用
- 高効率生産対応
スマートオペレーションシステム



モジュラーマウンタ G4 G5 印刷装置 P4

【効果】

- フレキシブルな生産対応
- ダウンタイムの軽減

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

24

■後工程市場動向

- ・10年度の後工程市場はメモリー向けが伸長
- ・メモリーでは、スマートフォンを筆頭にNANDの大容量化、ハイエンドサーバー/PC向けDRAMの転送速度が高速化
- ・それらを実現するための手段として、3次元実装や新型パッケージなど新しい技術が普及

■当社の取組み

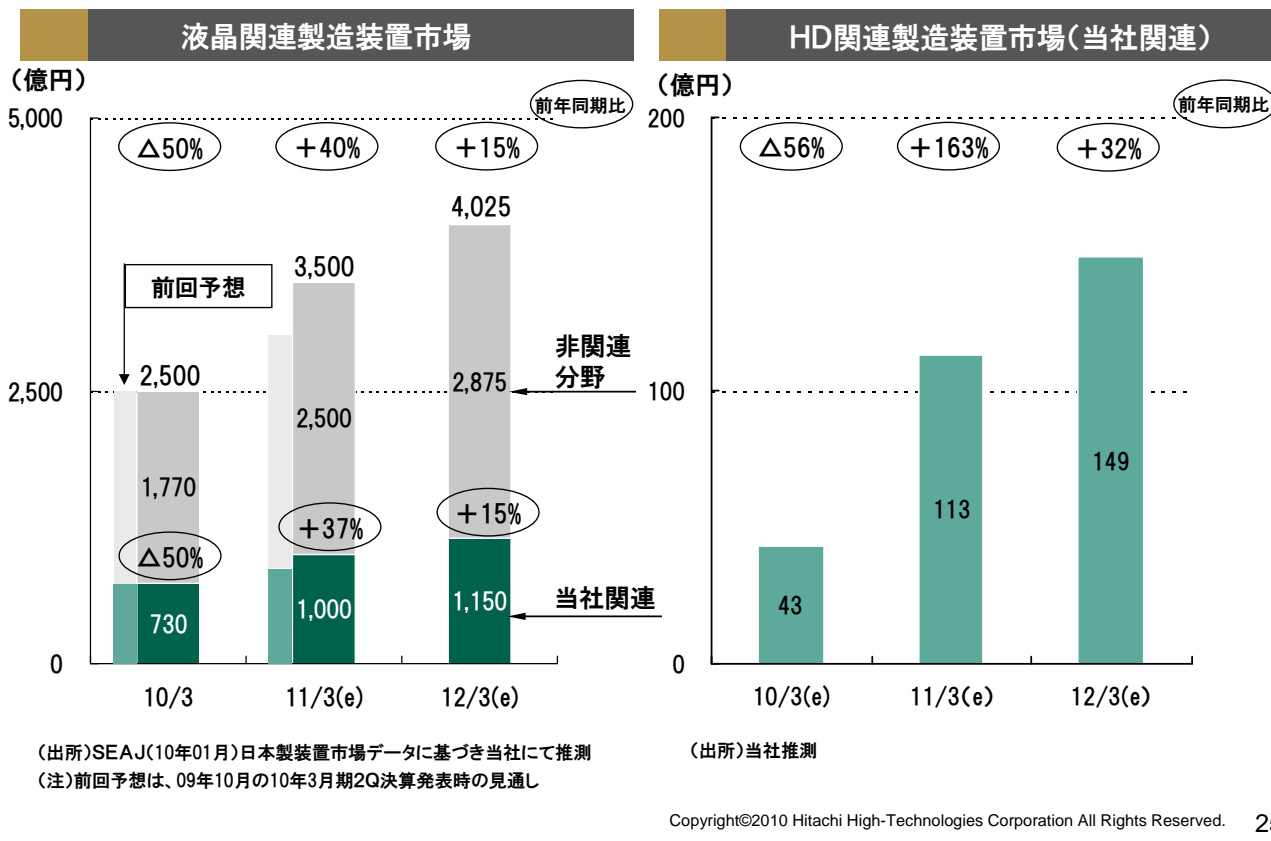
- ・2010年4月、ルネサス東日本セミコンダクタのダイボンダ事業を日立ハイテクインスツルメンツに統合し、製造・販売・サービス一体化によるシナジー効果で事業拡大
- ・新しい技術の導入に即した新製品を逐次投入

■表面実装市場動向

- ・電子機器の小型化や多機能・高性能化により、電子部品の小型・薄型化、高密度実装への対応が必須
- ・納入先は、中国を筆頭にアジア地区、南米など新興国にさらに拡大

■当社の取組み

- ・多様化する部品へ対応した新製品を市場投入
- ・ヘッド、部品供給トレイなどの交換時間短縮、生産品種の切替容易化、操作性の向上
- ・高速、高密度実装のニーズには、ダイレクトドライブヘッドやリニアモーターなど最先端のメカ&制御技術を搭載し高稼働率を実現
- ・ライン一括制御による操作性向上、メンテナンス性を向上させたスマートオペレーションシステムを採用



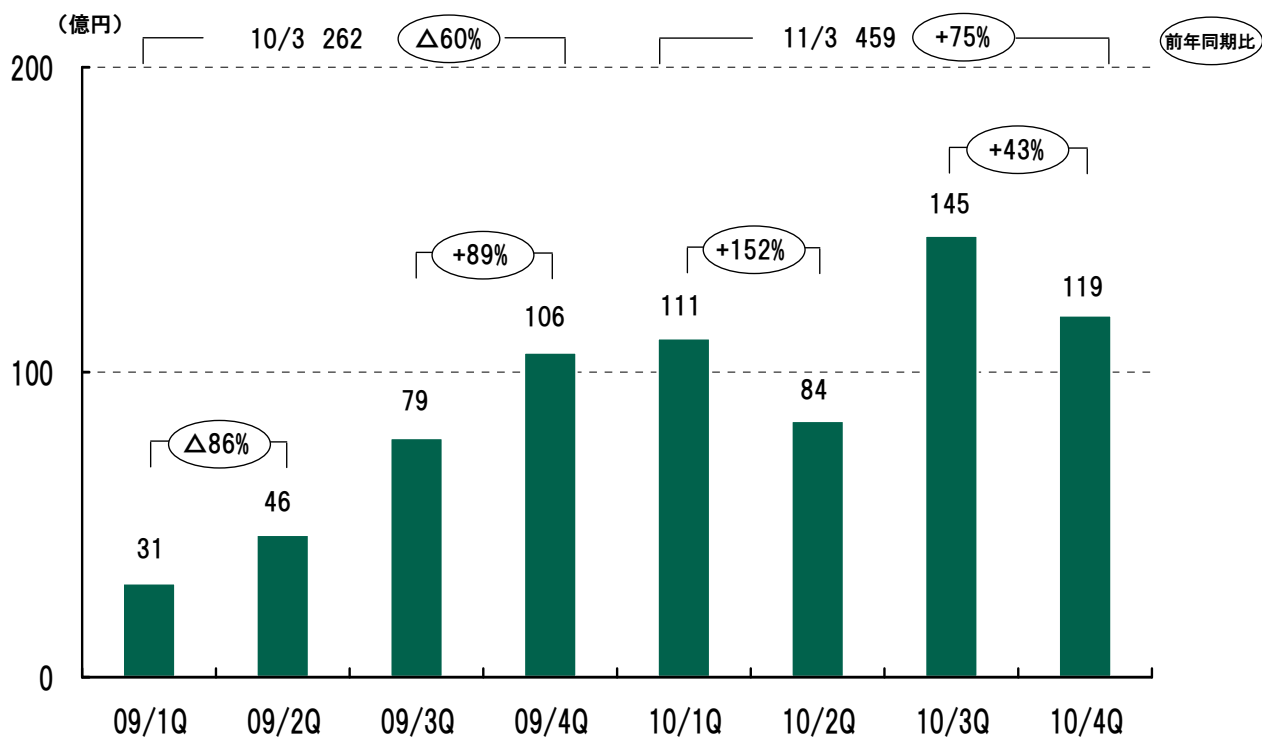
■液晶関連製造装置市場概況

- ・09年度:08年下期の経済危機の影響で、主要各社が投資計画を中止または延期したため、前半は非常に厳しい環境となった。後半は中国の内需拡大策などで液晶TVの販売が好調に推移、パネルメーカーの稼働率は上昇したものの、装置市場への影響は小さく、通年では△50%のマイナス成長
- ・10年度:中国パネルメーカーの他、日本、韓国、台湾の大手パネルメーカーが中国や新興国の需要を見込んで新工場建設の検討を進めることから、+40%のプラス成長を予想

■HD関連製造装置市場概況

- ・09年度:前半は世界不況の影響でHD業界全体が低迷したが、後半はPC、コンシューマー市場の拡大を背景に需要が回復。設備については、生産性改善や品質向上等に係る小規模投資が中心であり、△56%のマイナス成長
- ・10年度:新興国向け需要に加えPC、コンシューマー市場の需要拡大が継続。ディスクやサブストレートメーカーを中心に増産投資を見込み、+163%の大幅なプラス成長を予想

受注高の推移



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

26

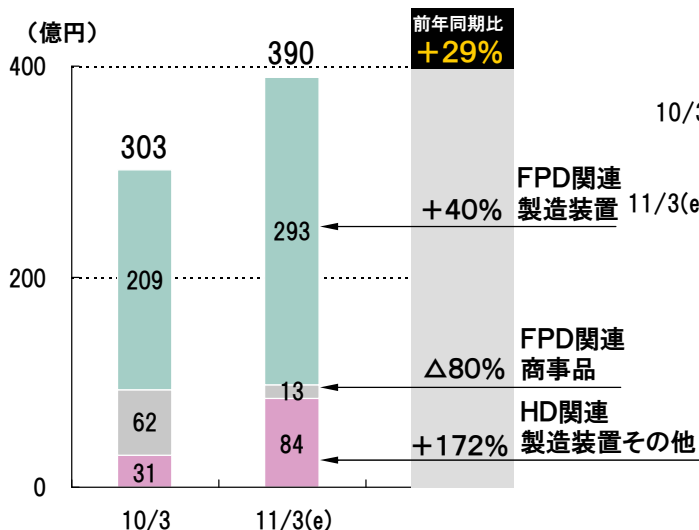
■受注高の推移

- ・10/上: 中国大陸・韓国の液晶前工程の設備投資により、前年同期比+152%、前期比+5%を予想
- ・10/下: 液晶の前工程投資が継続、加えて後工程投資がスタートすることで、前年同期比+43%、前期比+35%を予想

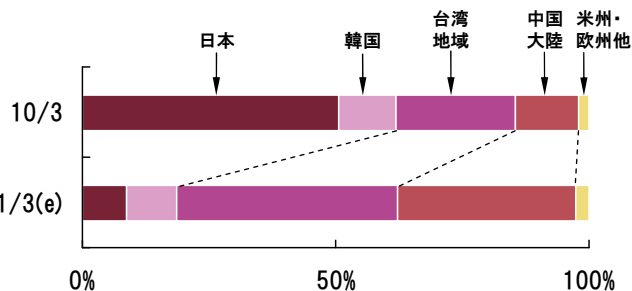
10年度基本戦略

1. 既存製品の競争力向上と新製品投入による事業拡大(新型実装機・ハードディスク検査装置)
2. 新規事業の開発加速(有機EL製造・検査装置)
3. 市場変動に強い事業体制への転換(中国営業力強化・コスト競争力強化)

主要製品群別売上高の推移



液晶関連製造装置 地域別売上高比率



- ・液晶関連の10年度の投資の中心は、台湾地域・中国大陸へシフト
- ・HD関連の09年度は生産改善が中心で、10年度は増産投資により大幅増

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

27

■基本戦略に対する今後の取組み

1. 既存製品の競争力向上と新製品投入による事業拡大
 - 1) 液晶関連
 - 高生産性・高精度の新型実装機の市場投入
 - 2) HD関連
 - ①新製品の市場投入
 - ・光学式ディスクテスト
 - ・ヘッド素子形状検査装置
 - ②サブストレート用表面検査装置の機能向上
2. 新規事業の開発加速
 - 有機EL製造・検査装置を11年度事業化予定
3. 市場変動に強い事業体制への転換
 - 1) 液晶の拡大市場(中国)へ営業力のシフト
 - 2) 調達、生産の改革によるコスト競争力の強化と短納期対応

■10年度 前年同期比増減説明


FPD関連製造装置

・中国大陸・台湾地域のパネルメーカー前工程投資再開により、自社製品は前年同期比+40%を予想

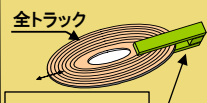
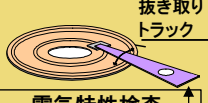
HD関連製造装置その他


・HDD需要拡大による増産投資により、前年同期比+172%を予想

【光学方式メディア検査装置】 ディスク全面検査による品質向上と検査コスト低減




光学方式メディア検査装置

	新概念装置	従来装置
検査方式	全トラック  光学式検査	抜き取り トラック  電気特性検査 (検査ヘッド)
検査エリア	全面検査 (品質向上)	全トラックの1%
消耗品	検査用ヘッド不要 (検査コスト低減)	検査用ヘッド使用

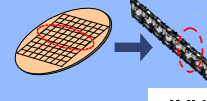
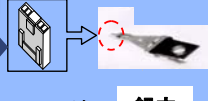



シェア拡大
20%UP

【ヘッド素子形状検査装置】 ヘッド組立前工程での検査による生産性向上



ヘッド素子形状検査装置

	新概念装置	従来装置
ヘッド工程	 ウェーハ 分断	 スライダー 組立
検査方式	ヘッド素子形状測定	電気特性測定
特徴	前工程での検査 (歩留り向上・コスト低減)	最終組立工程検査



ヘッド検査の
新市場創出

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 28

■今後の市場ニーズ

高密度化により、品質向上と生産性向上

ディスク分野

- ・新たに光学検査方式を採用し、高速かつ低ランニングコストでディスクを全数・全トラック検査するテストを市場投入しシェアを拡大

ヘッド分野

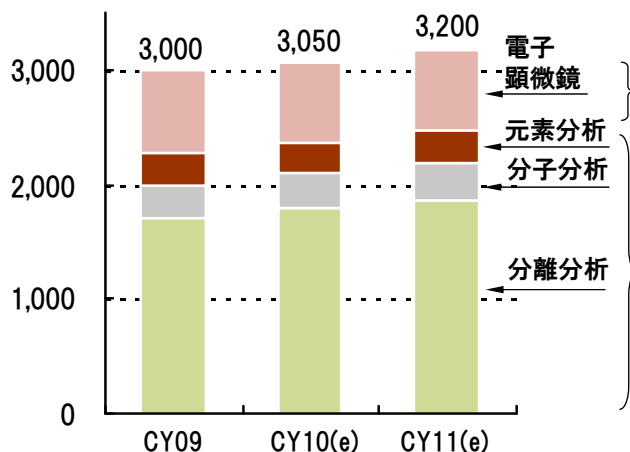
- ・上流工程で検査を行うことで生産性を大幅に向上する装置を市場投入し新しい市場を創出

10年度基本戦略

1. 成長市場(燃料電池、太陽電池、LED、製薬等)への積極的な拡販
2. バイオ系顧客への解析装置の販売強化及び半導体・材料顧客への汎用分析装置の拡販

分析関連市場概況(当社関連)

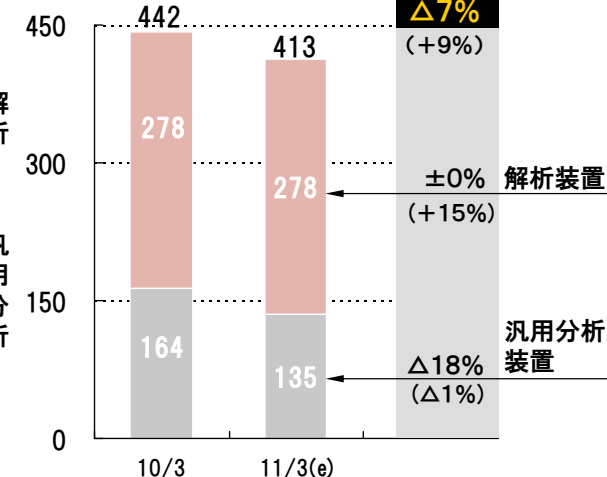
(億円)(売上ベース) CAGR 3%



(出所) SDI Global Assessment Report, Edition 10.5 等を基に当社推定

売上高の推移

(億円) ()補正予算影響を除く 前年同期比 $\Delta 7\%$



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

29

■基本戦略に対する今後の取組み

- ・アプリケーションおよびソリューションの開発・充実による成長市場(燃料電池・PV・LED・製薬等)への積極的な拡販
- ・解析・汎用分析事業のリソースの有効活用による顧客カバー率の強化
(化学・バイオ系顧客への電子顕微鏡の販売強化、半導体・材料系顧客への汎用分析装置の販売強化、販売代理店の共用化等)

■分析関連市場の状況説明

- ・09年度: 景気減速により電機・自動車・半導体・ディスプレイとその関連材料・部品メーカーの設備投資抑制の傾向が強まる。海外市場においても、欧米の景気刺激策の執行遅れや民需での投資抑制・買い控えが継続。年度後半では、国内の補正予算が執行。
- ・10年度: 民需全体の設備投資は未だ低調であるものの、半導体・LiB電池材料関連などの分野は引き合いが活発化。汎用分析の分子分析・元素分析関連は横ばいだが、分離分析は液体クロマトグラフを中心に伸長を期待。

■10年度 前年同期比増減説明(09年度補正予算影響を除く)

解析装置

- ・新製品の販売立上げおよび半導体・材料関連市場の需要回復に伴い、前年同期比+15%を予想

汎用分析装置

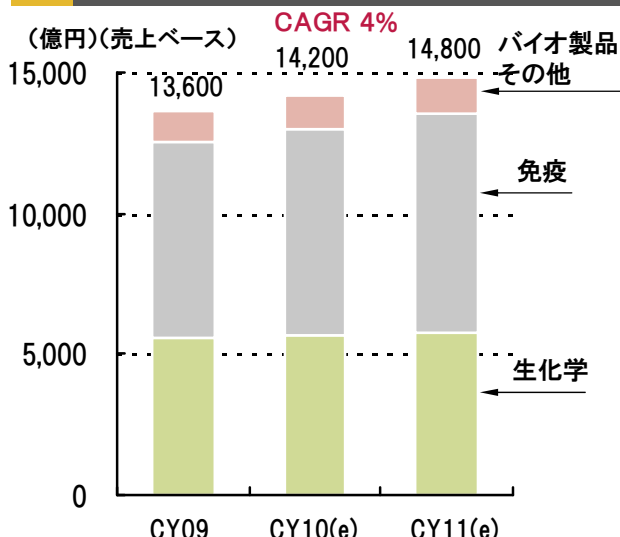
- ・民需の低迷を製薬分野向けの液体クロマトグラフ(分離分析)の販売強化、エレクトロニクス市場への分光光度計(分子分析)の拡販等によりカバーし、前年同期比 $\Delta 1\%$ を予想

10年度基本戦略

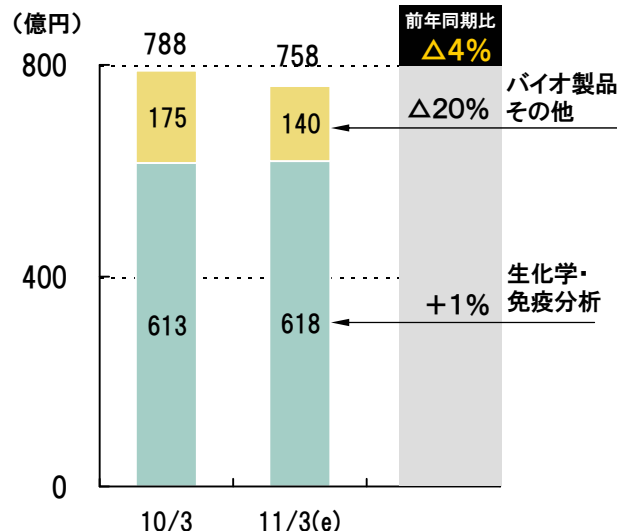
1. 国内外の有力メーカーとのSCB*の推進
2. 装置+試薬のシステム販売の推進(中国・日本)

*SCB: System Collaboration Business

バイオ・メディカル関連市場概況(当社関連)



売上高の推移



(出所)Kalorama Information 6th Edition(2008)他を基に当社推定(試薬、装置含む)

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

30

■基本戦略に対する今後の取組み

- ・国内外の有力メーカーとのSCBの推進(生化学・免疫・遺伝子他)
- ・装置+試薬のシステム販売の推進(日本国内向けにメタボ健診の1項目であるHbA1cを拡販中)
*HbA1c:ヘモグロビン・エイワンシー
- ・DNAシーケンサの診断分野への対応と次世代装置開発の推進

■バイオ・メディカル関連市場の状況説明

- ・09年度・10年度:医療費抑制の継続により病院の経営環境が悪化し、検査センターへの外注化が進行。
国公立大学・病院の独法化によりコスト重視傾向が強まり、競合が激化するも、高効率・高品質な機器へのニーズは高い。
免疫分野は5%伸長も、生化学分野はほぼ横ばいを予想。
DNAシーケンサは6%伸長。次世代機を中心にゲノム研究分野での需要が伸長、現行機ではアプライドマーケットが比較的堅調。

■10年度 前年同期比増減説明

- ・09年度の海外の大規模病院への検体前処理システム導入の一巡およびDNAシーケンサのスポット大口案件の反動を、生化学・免疫の新大型システムの販売立上げにより挽回を図るも、前年同期比△4%を予想

● 遺伝子検査とは

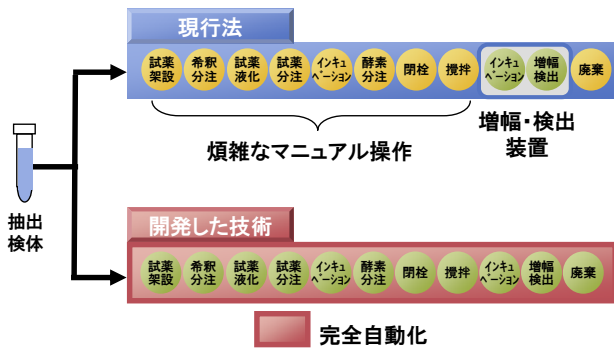
病原微生物の遺伝子(核酸)の種類、感染程度(量)を測定することにより、感染症等の早期発見、早期治療が可能

具体例: 感染症検査

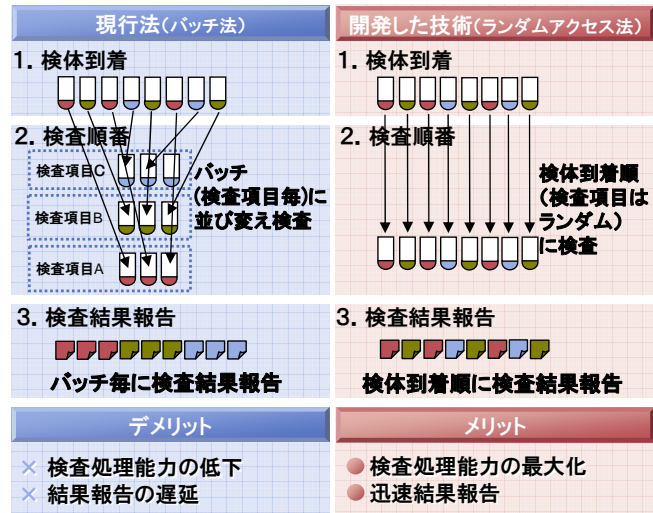
遺伝子検査	操作性	迅速報告
現行法	×	△
開発した技術	○	○

● 技術の特徴

1. 煩雑なマニュアル操作を完全自動化



2. ランダムアクセス化による報告の迅速化



● 今後の進め方

- ・ 試薬メーカーとのコラボレーション推進
- ・ 11年度上市予定(研究市場)

■ 遺伝子検査とは

病原微生物の遺伝子(核酸)の種類、感染程度(量)を測定することにより、感染症等の早期発見、早期治療が可能。

具体例の説明:

現行の遺伝子検査に比較して、検査工程を自動化することにより操作性の向上と検査業務の省力化を実現。さらに、ランダムアクセス化により、検査ワークフローを改善し、検査結果を迅速に報告することを実現。

■ 技術の特徴

1. 煩雑なマニュアル操作を完全自動化

煩雑なマニュアル検査工程を自動化し、検査業務の完全自動化を実現。

2. ランダムアクセス化による報告の迅速化

現行法のバッチ方式では、検査室に検体が到着後、検査項目毎に並び替え、バッチ単位(複数まとめて)で検査を開始することから、処理能力や検査結果報告の遅延が課題。

今回開発した技術は、検体を検査項目毎に並び替えることなく、検査室に検体が到着した順番に、1検体単位から検査を開始できるランダムアクセス方式。これにより、処理能力の向上と迅速な検査結果報告が可能、現行法の課題を解決。

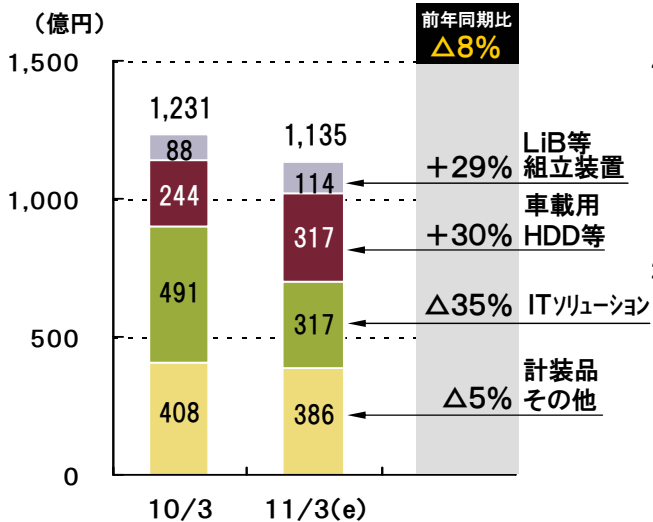
■ 今後の進め方

- ・ 試薬メーカーとのコラボレーションを進め、遺伝子分野におけるSCB(System Collaboration Business)の推進を図る
- ・ 研究目的の市場で11年度の上市を予定

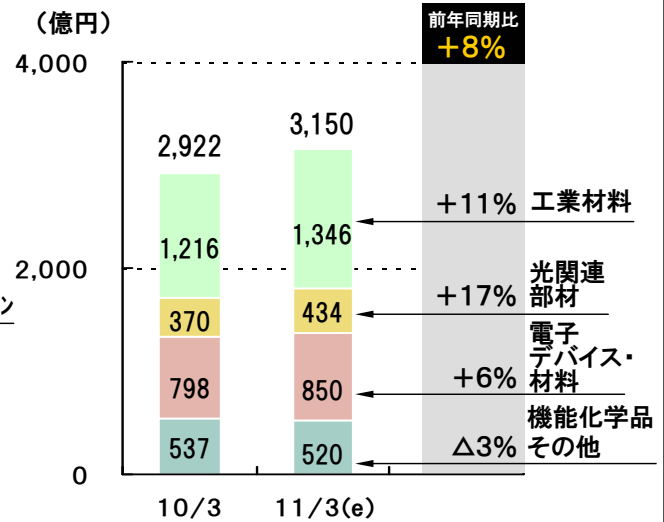
10年度基本戦略

1. 環境エネルギー事業の拡大(PV・リチウムイオン電池等)
2. 成長地域戦略の加速(BRICs～VISTA)

産業・ITシステム 売上高の推移



先端産業部材 売上高の推移



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 32

■基本戦略に対する今後の取組み

1. 環境貢献型ビジネスの拡大
→米国ゼロコート社との戦略的パートナーシップの確立による太陽電池関連装置事業の拡大
2. 成長地域戦略の加速
→BRICs～VISTAの成長市場での事業戦略加速

■10年度 前年同期比増減説明

産業・ITシステム

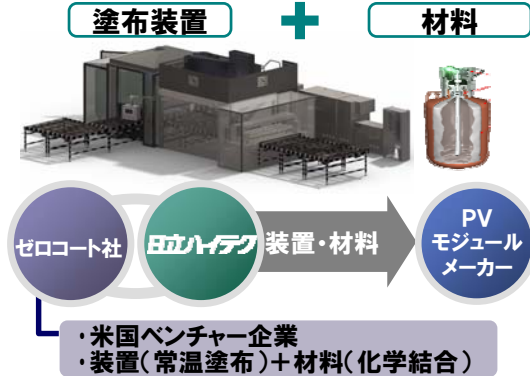
- ・LiB等組立装置は、環境適合車普及によるLiB組立装置等の売上により、前年同期比+29%を予想
- ・車載用HDD等は、HDDの当社シェアアップ、及び電池材料等の増加により、前年同期比+30%増加を予想
- ・ITソリューションは、米国向け携帯端末の現行モデル需要減少の一方、新モデル機種投入により後半の立ち上げを見込むも、前年同期比△35%を予想

先端産業部材

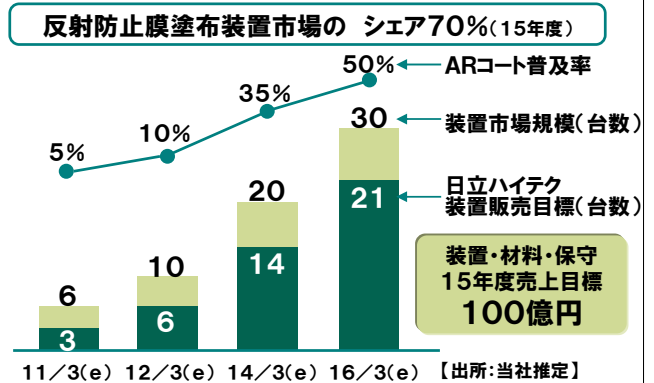
- ・工業材料は、世界経済回復に伴う素材の物量増加、価格上昇により、鉄鋼・樹脂等の工業材料品取扱増加を見込み、前年同期比+11%を予想
- ・光関連部材は、新規アジア顧客ビジネスの立ち上げにより、前年同期比+17%増加を予想
- ・電子デバイス・材料は、半導体市況改善によりシリコンウエーハは顧客増産に伴う売上増を見込み前年同期比+6%増加を予想

PV関連装置・材料事業の拡大（米ゼロコート社との戦略的パートナーシップ確立）

PV用ARコート塗布装置および材料



事業目標



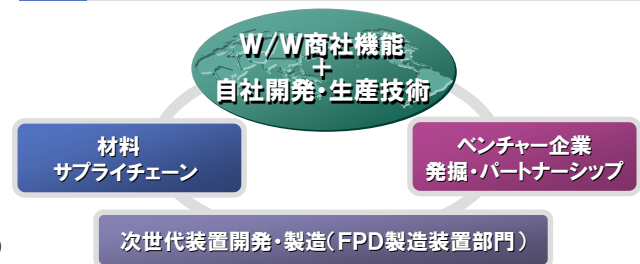
技術比較

方式	ゼロコート社	スパッタ/CVD	エッチャー	Sol-Gel
効率(垂直)	○	○	△	△
プロセス容易性	○	×	×	×
コーティング価格	200¥/㎡	400¥/㎡	500¥/㎡	600¥/㎡

ARコート	透過率	発電量改善
無し	4%反射	96%
塗布後	1%反射	99%

透過率改善 → 発電量 3%改善

商社機能と自社製品機能の融合



Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

33

■PV用ARコート塗布装置および材料

- ・アメリカベンチャー企業「ゼロコート社」と同社の特徴ある「PV用ARコート塗布装置と材料」について戦略的パートナーシップを確立。

■技術比較

- ・製造プロセスが容易なことから競合製品との比較でコーティング価格が圧倒的に安く、発電効率に優れる。
- ・ゼロコート社製ARコートを塗布することにより発電効率が3%改善。効率競争が激化しているPVモジュールメーカーにとって大変魅力的な改善。

■事業目標

- ・ARコート塗布市場のシェア70%を目指す。
- ・15年度には装置21台の販売を行い、材料、装置の保守などを合わせ売上100億円を目標とする。

■商社機能と自社製品機能の融合

ワールドワイドな商社機能で、ベンチャー企業を発掘しパートナーシップを構築し、自社製品部門の「自社開発・生産技術」を融合し、「ARコート市場の装置・材料・保守のバリューチェーン」に幅広く対応してグローバルトップを目指す。

IV 参考:データ集

(注)YY/MはYY年M月期を表しています。

四半期業績の推移

(億円)

	08年1Q	08年2Q	08年3Q	08年4Q	09年1Q	09年2Q	09年3Q	09年4Q
売上高	1,829	2,404	1,633	1,883	1,325	1,492	1,451	1,901
営業利益	19	106	23	1	△38	△38	4	56
経常利益	26	113	30	△4	△32	△37	8	57
当期利益	△2	78	20	△25	△20	△33	△3	28

■セグメント別売上高

(億円)

	08年1Q	08年2Q	08年3Q	08年4Q	09年1Q	09年2Q	09年3Q	09年4Q
電子デバイスシステム	250	612	327	494	200	233	238	470
ライフサイエンス	248	243	213	273	207	233	217	297
情報エレクトロニクス	443	616	420	558	352	398	384	462
先端産業部材	888	933	673	558	566	628	613	672

(億円)

	09/3	10/3	前年同期比	11/3(e)	前年同期比
設備投資額	122	94	△23%	118	+26%
減価償却費	95	96	+1%	103	+8%
研究開発費	215	193	△10%	222	+15%

(注)設備投資額は取得ベースにて記載

前年同期比 増減説明(09年度)

設備投資額:29億円減少

- ・那珂事業所新製造棟建設等

研究開発費:22億円減少

- ・電子デバイスシステム、ライフサイエンスの要素技術開発等

09年度売上高実績(新旧セグメント)リステート明細表

(単位:億円)

No.	セグメント		サブセグメント		09年度実績		(b)-(a)	主な変更対応項目No.	
	旧	新	旧	新	(a)旧	(b)新			
1	電子デバイスシステム	電子デバイスシステム	プロセス装置	プロセス製造装置	201	204	3	8	
2			評価・解析装置	評価装置	519	242	△ 277	11	
3				後工程・実装装置	0	138	138	8,16	
4				合計	720	584	△ 136		
5		ファインテックシステム	液晶関連製造装置	FPD関連製造装置	224	272	48	8	
6			HD関連製造装置	HD関連製造装置その他	17	31	14	8	
7				合計	241	303	62		
8			その他		180	0	△ 180	3,5,6,21,28	
9				合計	1,141	887	△ 254		
10	ライフサイエンス	科学・医用システム	バイオ・分析	汎用分析機器		164		13	
11				解析装置	213	278	229	2	
12				メディカル	生化学・免疫分析装置		613		
13					バイオ製品その他	708	175	80	10
14				その他		34	0	△ 34	10,11,12,13,28
15			合計	955	1,230	275			
16	情報エレクトロニクス	産業・ITシステム	組立装置	LiB等組立装置	162	88	△ 74	3	
17					車載用HDD等	0	244	244	18
18				情報システム	ITソリューション	733	491	△ 242	17
19				半導体		193	0	△ 193	24
20				メディアデバイス		176	0	△ 176	24
21				その他	計装品その他	331	408	77	8,28
22					合計	1,595	1,231	△ 364	
23	先端産業部材	先端産業部材	工業材料	工業材料	1,168	1,217	49	26	
24				電子デバイス材料	電子デバイス・材料	526	798	272	19,20,26
25				光関連部材	光関連部材	357	370	13	26
26				その他	機能化学品その他	427	537	110	23,24,25,28
27					合計	2,478	2,922	444	
28			消去または全社	0	△ 100	△ 100	8,14,21,26		
29			全社合計	6,169	6,169	0			

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved. 37

■09年度売上高実績(新旧セグメント)リステート明細の見方

10年度からのセグメント変更に伴い、前年度比較をする09年度の旧セグメントを新セグメントへ変更(リステート)したものです。

表右端の「主な変更対応項目No.」は、表左端の項目No.に対応します。

(例)

左端No.3項「後工程・実装装置」の差額((b)-(a)) = 138億円

同項右端「主な変更対応項目No.」: 8,16

↓

No.3項の「138億円」は、「No.8項、No.16項」に対応していることを示します。

<資料取り扱い上の注意>

- ① 本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結です。
- ② YY/M(e)はYY年M月期予想を表しています。
- ③ 数値情報は、億円未満を四捨五入しています。
- ④ 本プレゼンテーションで述べられている将来の当社業績に関する予想は、現時点で知りうる情報をもとに策定されたものです。当社の参画する産業界はテクノロジーの変化が速く、競争の激しい産業です。また、世界経済、半導体市況、為替相場など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、今後、当社の業績が本プレゼンテーションと異なる可能性があることをご留意ください。但し、大きな変動がある場合は、証券取引所の適時開示規則及び当社の自発的判断等に基づき、その都度公表していく所存です。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

END

2010年3月期 決算説明会

お問合せ先
社長室 広報・IRグループ 部長代理 加藤 弘之
TEL:03-3504-5138 FAX:03-3504-5943
E-mail:kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com

日立ハイテク

最先端を、最前線へ。

Copyright©2010 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.